

证券代码：688216

证券简称：气派科技

气派科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	信达证券 张洪滨 信达证券 宿一赫
时间	2026年3月10日 10:30-11:30
地点	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 文正国
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、在传统封装竞争比较激烈的情况下，请问公司的自研封装产品有哪些，以及该产品在封装行业内公司的技术壁垒主要在哪里？</p> <p>答：在传统封装方面，公司早期推出了 Qipai 系列，可替代 DIP 系列和部分 SOP 系列，该系列在产品生产效率、材料成本及功能性提升方面具有较强的优势，随着手机周边及可穿戴设备等消费电子的需求增长，对芯片的体积有所要求，公司自研了 CPC 系列，从产品体积、生产效率、材料成本、功能性提升方面进行了研发，可替代 SOP 系列和部分 QFN、DFN 系列。公司自研封装形式不是简单的将产</p>

品尺寸缩小，而是整个生产工艺流程的设计、验证。

2、请问公司的自研产品是如何被客户接纳的？

答：公司通过持续的推广，再加上终端应用对芯片体积的需求，逐步得到客户认可。

3、请问公司目前将主要精力放在哪方面？

答：首先，公司不断拓展 IC 封装的高端产品和高端客户，以保证 IC 封测的业务增长，其次，逐步丰富功率器件封装品类，以保证功率器件封测的高增长，然后，聚焦于晶圆测试方面业务拓展，最后，瞄准个别先进封装实现单点突破。

4、请问公司功率器件的团队搭建、技术能力现在情况如何？

答：公司自 2021 年就开始储备和引进功率器件相关的技术人员，目前的功率器件人员、技术搭建比较稳定，订单持续增长。

5、请问公司是否通过了车规级认证？

答：行业内对车规产品要求高，需要与客户高度融合合作，目前公司已通过了车规级认证，车规产品在逐步导入。

6、请问公司如何看待目前行业的景气度？

答：封装测试行业从去年下半年开始回暖，目前景气度没有降温迹象，行业扩产在持续、产能也比较紧张。

7、公司目前的原材料成本情况如何，对客户是否有进行

	<p>价格调整?</p> <p>答：由于原材料价格的调整，公司也从春节开始针对不同客户和不同产品在持续开展价格调整事宜。</p> <p>8、请问公司是否有并购计划?</p> <p>答：公司对并购采取谨慎保守的态度，公司属于重资产行业，考虑到并购公司之后的折旧等财务影响，公司的并购希望做到在正常经营的前提下通过并购赋能，从而对公司有市场规模的拓展带来外延式增长。</p>
	无
日期	2026年6月11日